

# 株式会社 東京精密 2018年度(平成31年3月期) 第2四半期 決算説明会

2018年11月13日

\*

### ◆ 将来の事象に係わる記述に関する注意

- 本資料に記載されている情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。
- これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。
- 従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

### ◆ 表記データ・用語について

- 注記がある場合を除き、**半導体製造装置セグメント**を「半導体」、**精密計測機器セグメント**を「計測」、また**親会社株主に帰属する当期純利益**を「当期純利益」と記載します。
- 記載されている金額や比率の情報は、注記がある場合を除き、億円またはパーセントによる要約表示を行っております。その為、内訳の計が、合計と一致しない場合があります。

### ◆ 監査について

- 本プレゼンテーション資料は、監査法人による監査の対象外です。

## 次第

- ◆ 2018年度第2四半期 業績説明
- ◆ 中期目標の進捗
- ◆ 2018年度通期業績予想
- ◆ 質疑応答

単位：億円	2017年度		2018年度		
	上期	下期	上期	前下期比 H/H	前年同期比 Y/Y
<b>売上高</b>	<b>437</b>	445	<b>512</b>	+15%	+17%
半導体製造装置	303	292	358	+23%	+18%
計測機器	133	154	154	+0%	+16%
<b>営業利益</b>	<b>89</b>	84	<b>102</b>	+22%	+15%
半導体	64	49	68	+39%	+8%
同率	21%	17%	19%	-	-
計測	26	34	34	-0%	+33%
同率	19%	22%	22%	-	-
<b>経常利益</b>	<b>90</b>	82	<b>108</b>	+30%	+19%
<b>当期純利益</b>	<b>64</b>	64	<b>79</b>	+24%	+24%

- 半導体では一部部材の納入遅延について一定の改善が見られ、出荷が進み、Y/Yで増収増益
- 計測は、自動車・工作機械関連需要が堅調、増収増益

Nov 13th, 2018

Copyright 2018 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

4

- 18年度上期(4-9月)は、両事業とも堅調に推移、増収増益の着地
- 売上高 512億円 (半導体製造装置 358億円、計測機器 154億円)
- 営業利益 102億円 (半導体 68億円、計測 34億円)
- 経常利益 108億円、当期純利益(親会社株主に帰属する)は79億円
- 営業利益、経常利益、当期純利益はともに半期ベースでの過去最高

単位: 億円	2017年度				2018年度			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	前 四半期比 Q/Q	前年 同期比 Y/Y
売上高	199	238	192	253	198	314	+58%	+32%
半導体製造装置	142	161	126	166	128	230	+79%	+43%
計測機器	57	76	67	87	70	84	+19%	+10%
営業利益	40	49	36	48	31	71	+127%	+46%
半導体	31	32	22	28	16	52	+220%	+62%
同率	22%	20%	17%	17%	13%	23%	-	-
計測	9	17	14	20	15	19	+26%	+14%
同率	16%	22%	22%	23%	21%	23%	-	-
経常利益	41	49	36	46	34	74	+121%	+51%
当期純利益	29	35	26	38	26	53	+109%	+54%

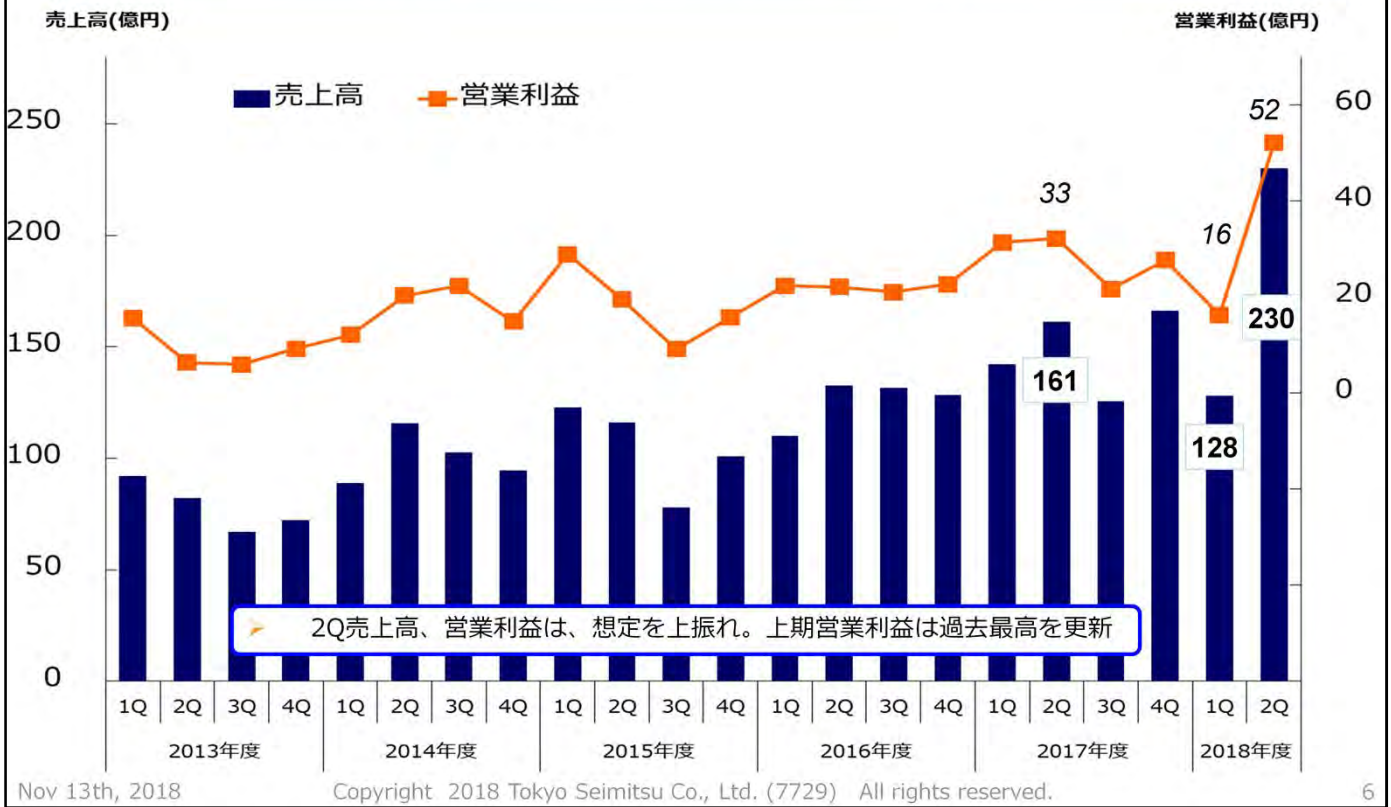
▶ 半導体は、1Qに対して出荷が大幅に増加

Nov 13th, 2018

Copyright 2018 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

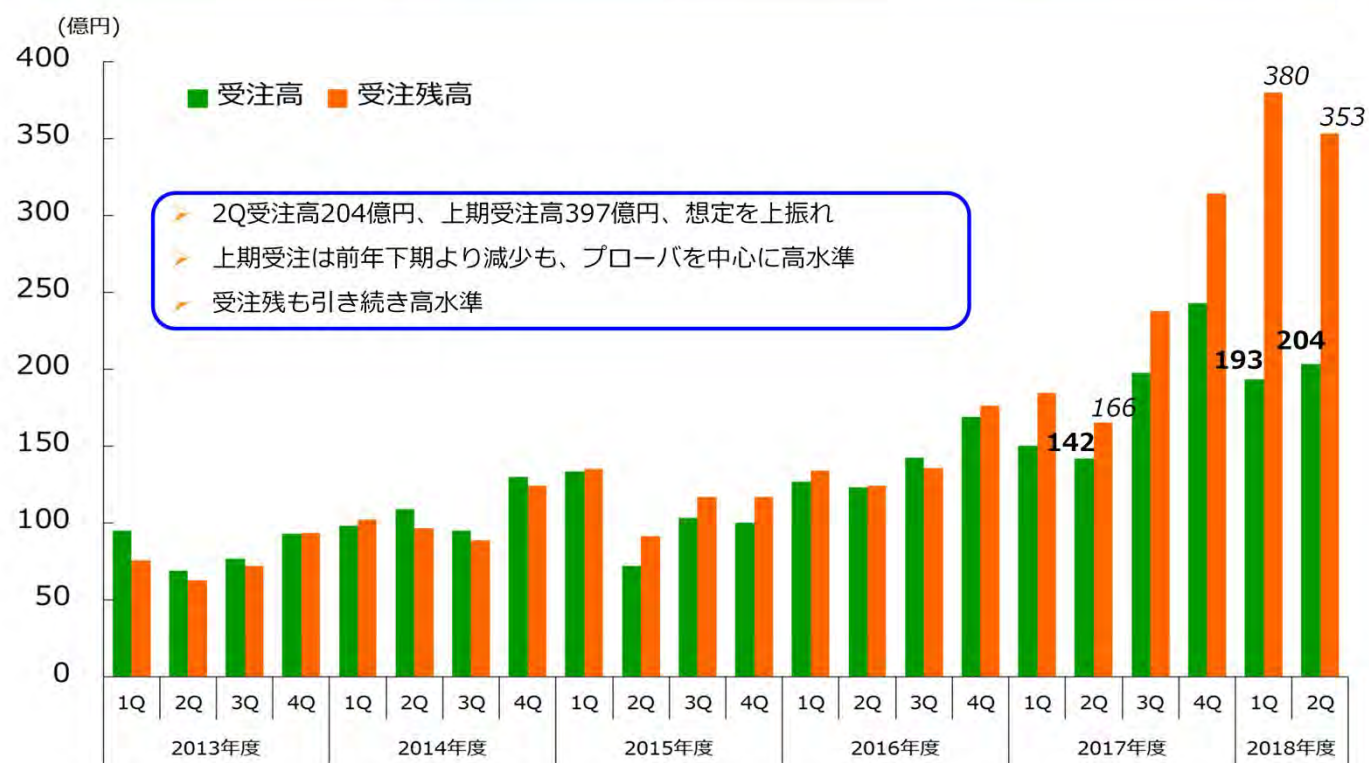
5

- 2018年度第2四半期(7-9月、以下2Q)の業績概要
- 売上高 314億円(半導体 230億円、計測 84億円)
- 営業利益 71億円(半導体 52億円、計測 19億円)
- 経常利益 74億円、 当期純利益 53億円
- いずれも前四半期、前年同期比増収増益



○ 2Q売上・利益とも、想定を上振れる着地

○ 装置需要が用途(デバイス種別)問わず好調、出荷も進んだことによる

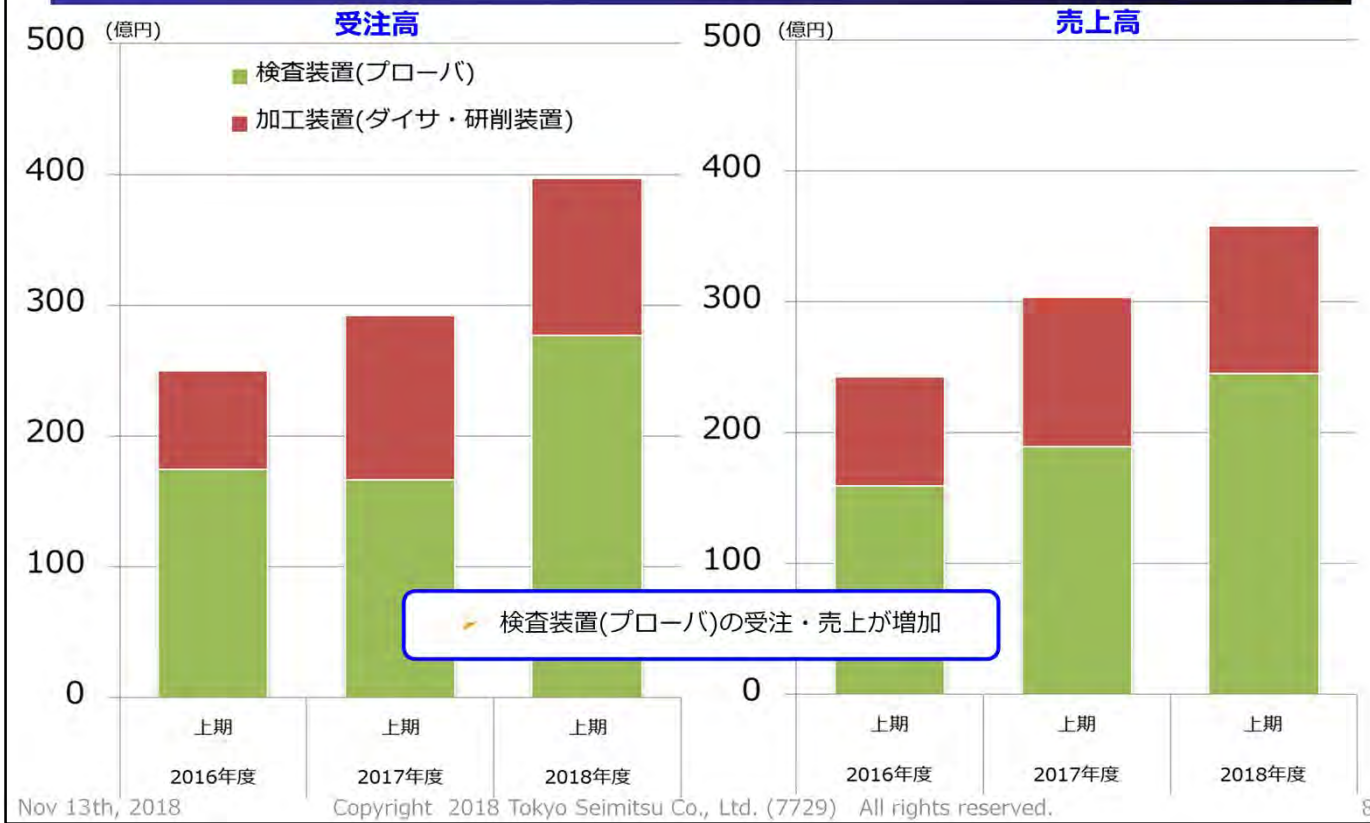


Nov 13th, 2018

Copyright 2018 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

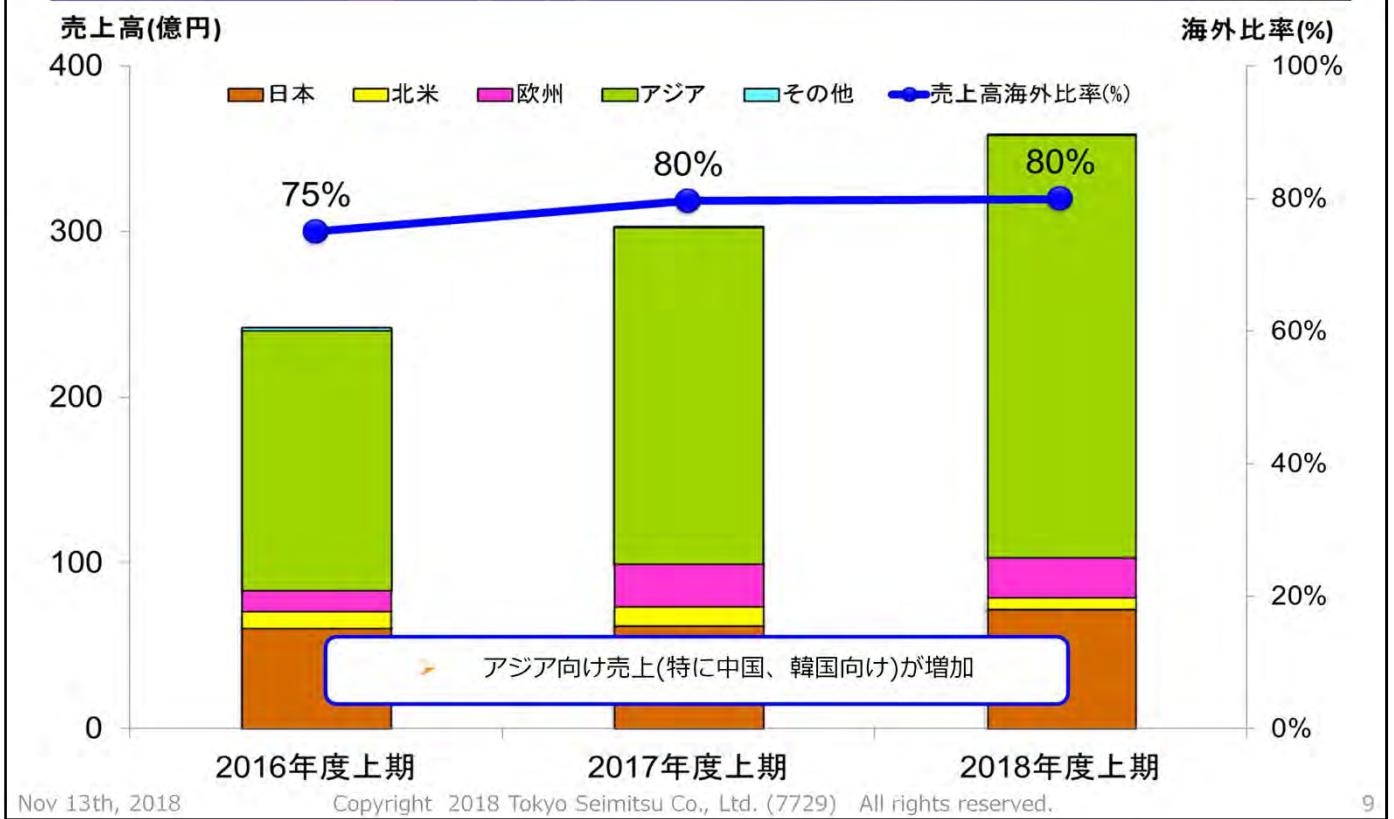
7

- 2Q受注高は204億円、プローバ受注が高水準で、想定を上振れる着地
- 上期受注高は397億円
- 2Q受注残高は353億円と 高水準

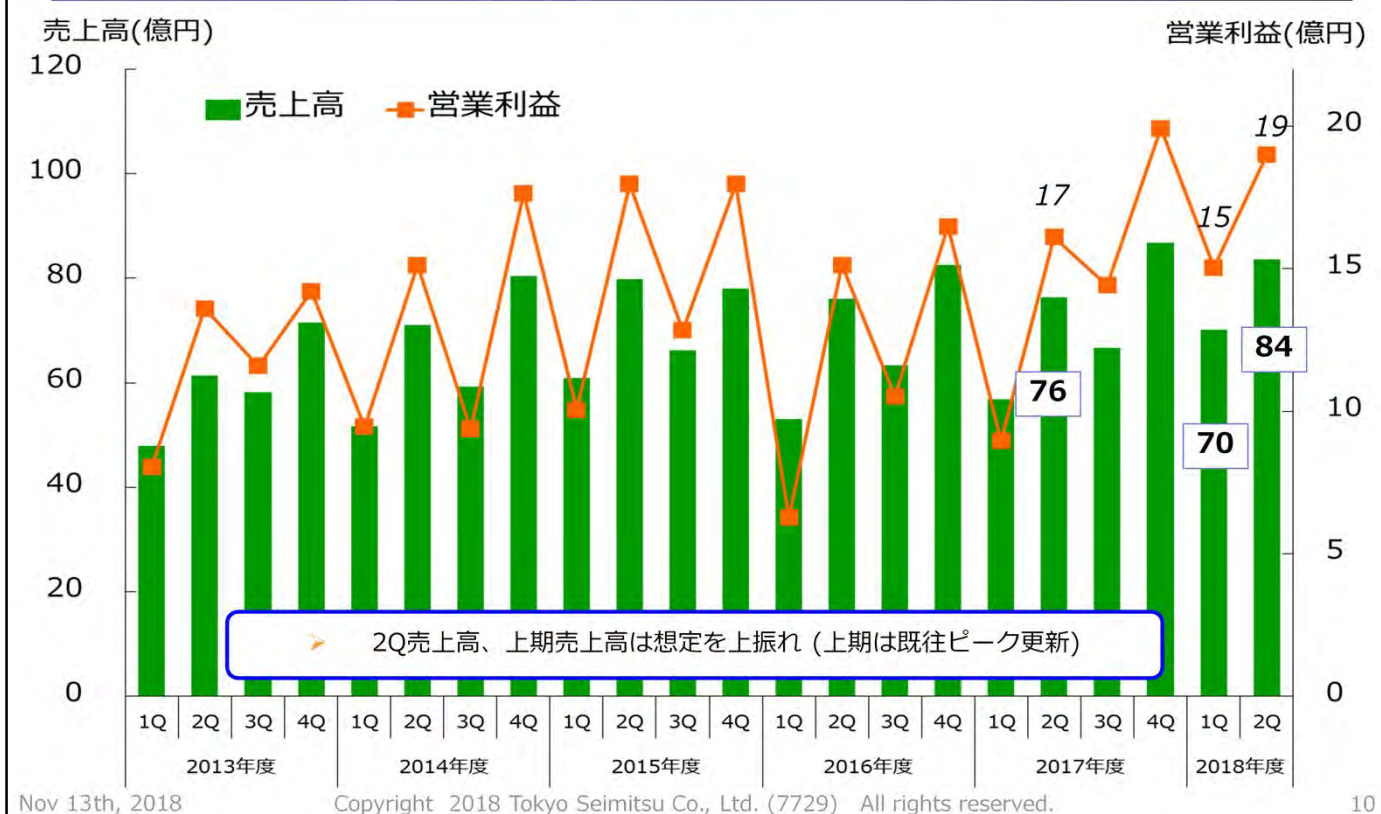


- 2018年度上期は受注・売上とも検査装置（プローバ）で増加
- 製品構成比は、受注・売上とも、  
検査装置（プローバ）7割、加工装置（ダイサ、研削装置等）3割

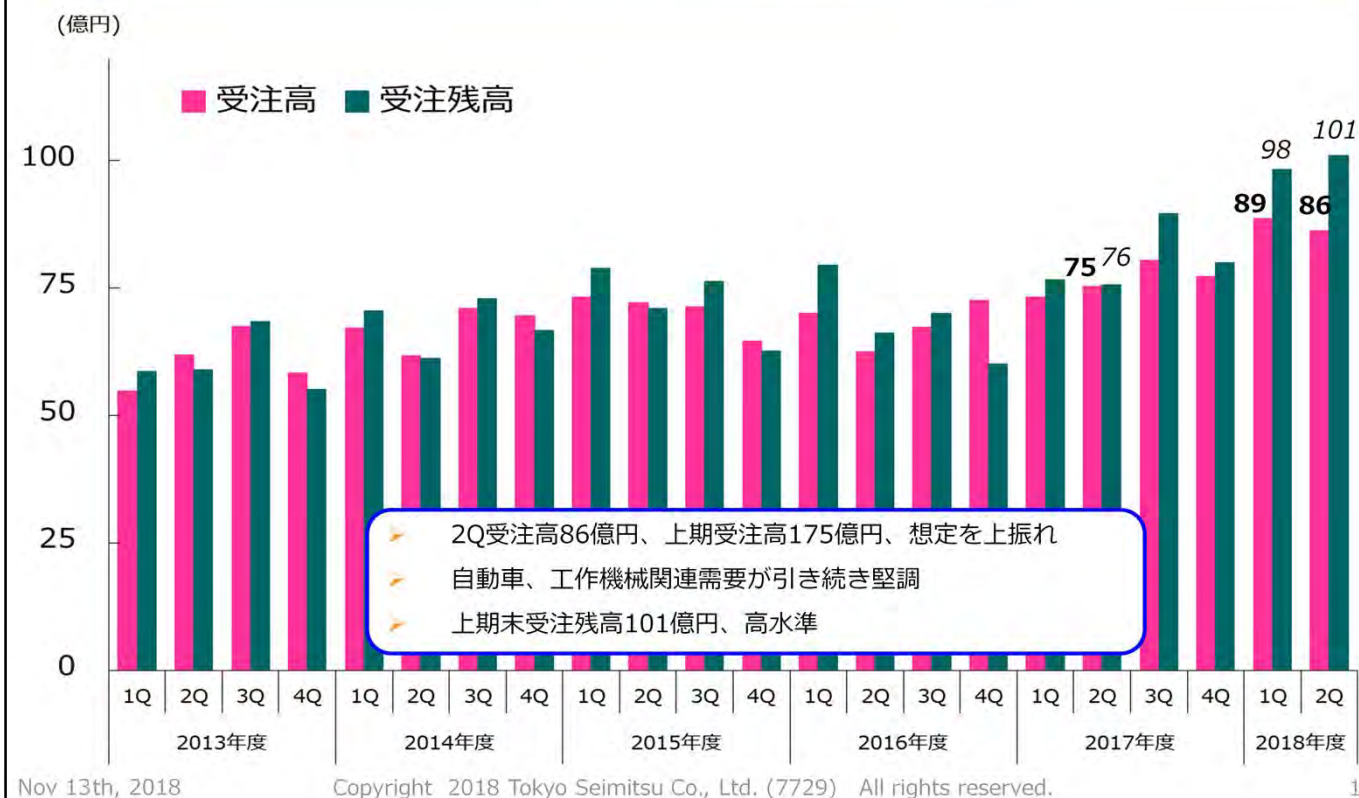




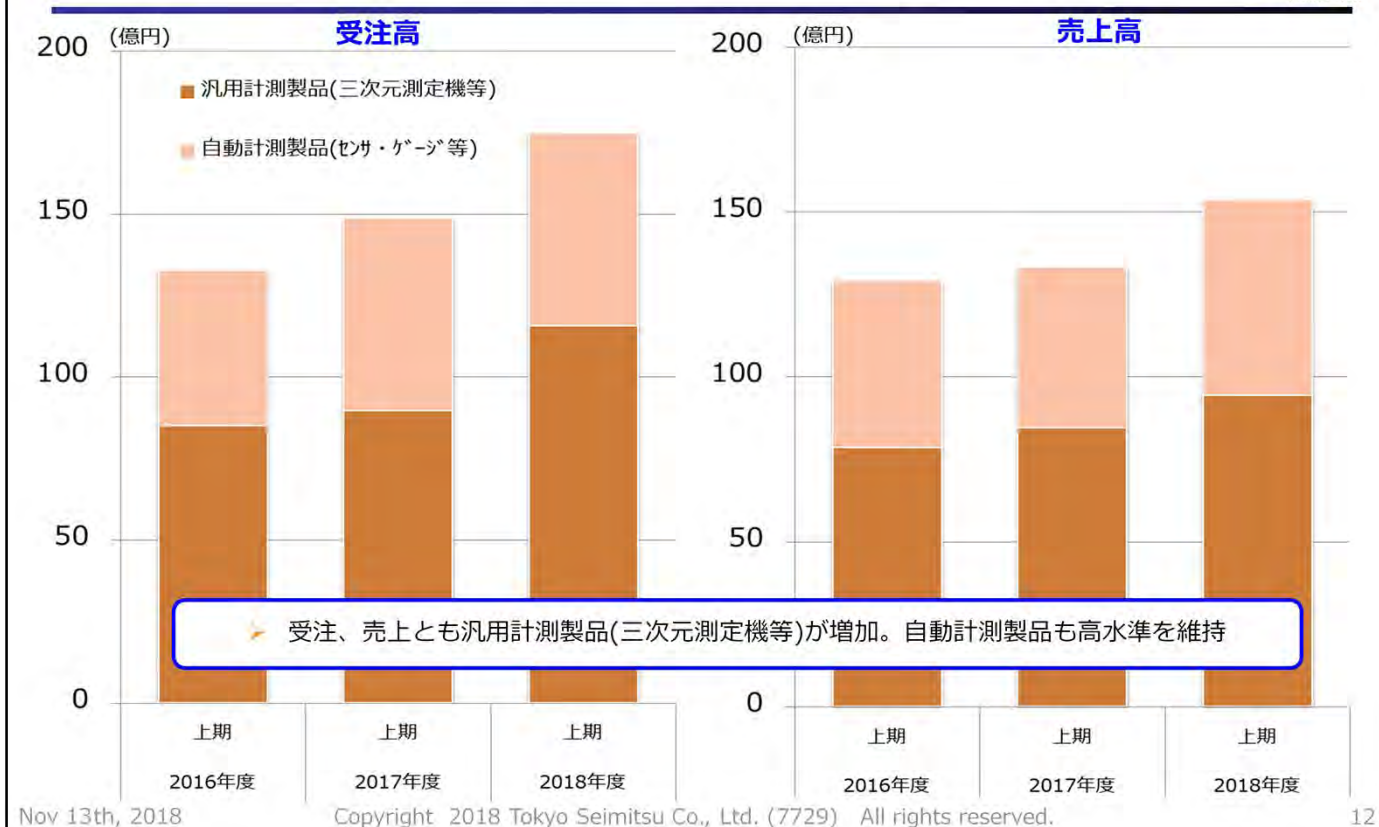
- 海外売上高比率は80%
- 国内向けが安定的に推移する一方、アジア地域向けが大幅に増加 (中国、韓国などで増加)



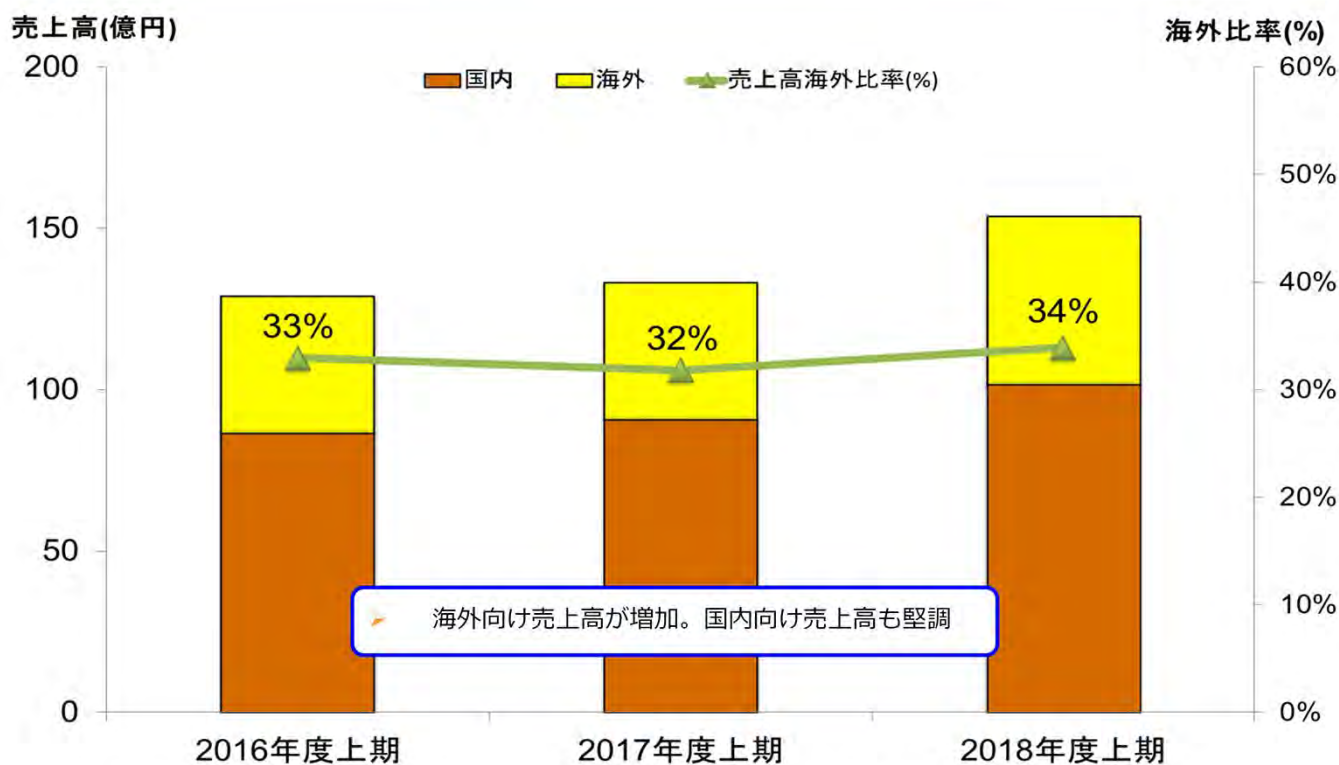
- 第2四半期は売上、利益とも想定上振れ  
上期実績は前年同期比で増収増益
- 上期売上高は前年下期の既往ピークを更新



- 計測事業の2Q受注高は86億円、上期受注高は175億円
- 国内の自動車業界むけ(受注の過半)と、連動する工作機械関連の引合いの堅調さを背景に、受注は堅調
- 受注残高は高水準を維持



- 2018年度上期は受注・売上とも、三次元座標測定器を中心に汎用計測製品が増加。
- 製品別構成比は、
  - 受注：汎用計測6割、自動計測 4割
  - 売上：汎用計測6割台前半、自動計測 3割台後半



Nov 13th, 2018

Copyright 2018 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

13

- 海外売上高比率は、34%
- 国内向けは堅調に推移したことに加え、  
日系メーカーの海外投資が増加、海外比率は上昇

資産 (億円)	18/3末	18/9末	増減	負債/純資産 (億円)	18/3末	18/9末	増減
現預金	372	409	+37	支手・買掛金, 電子記録債務	219	256	+37
受取手形・ 売掛金・ 電子記録債権	334	346	+11	短期借入金	13	13	±0
在庫	223	246	+23	その他	96	90	-6
その他	20	13	-7	<b>流動負債計</b>	328	359	+31
<b>流動資産計</b>	950	1,015	+65	<b>固定負債計</b>	7	6	-1
<b>固定資産計</b>	379	394	+15	<b>負債計</b>	335	365	+30
<b>資産合計</b>	1,329	1,409	+80	<b>純資産</b>	994	1,043	+50
				<b>負債・純資産合計 (内有利子負債)</b>	1,329 (13)	1,409 (14)	+80 (+0)

Nov 13th, 2018

Copyright 2018 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

14

- 9月末の総資産は1,409億円 (3月末比80億円増)
- 資産増加の内訳は  
流動資産が65億円増加(現預金37億円増、売上債権11億円増、在庫23億円増)  
固定資産が15億円増加
- 負債合計は365億円(買掛債務増加を主因に30億円増加)
- 純資産は1,043億円(50億円増加)
- 自己資本比率は73.3%、9月末の有利子負債残高は14億円

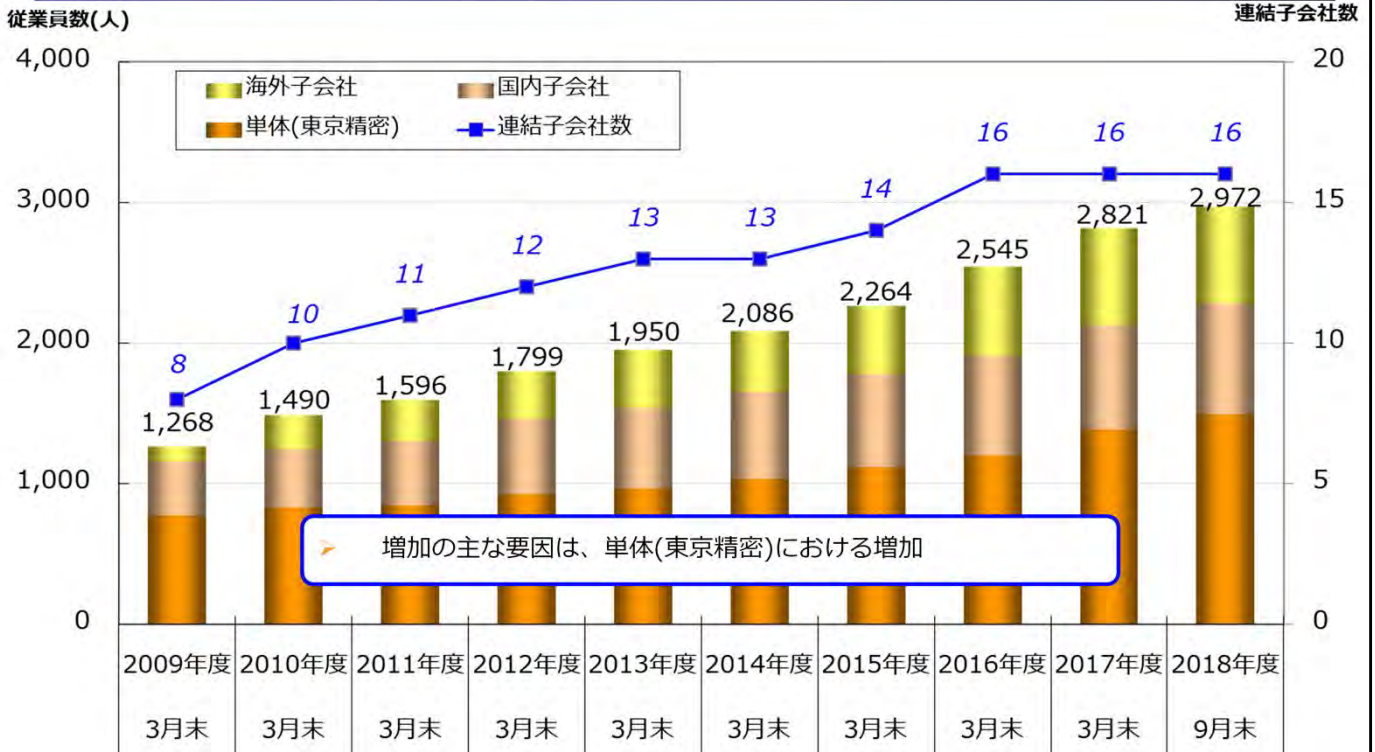
		単位：億円		
		2016年度上期	2017年度上期	2018年度上期
現金等 期首残高		273	338	371
営業活動	税引前・償却前利益	75	103	121
	(売上債権+在庫) - 仕入債務	27	- 5	- 1
	納税	- 19	- 40	- 33
	その他	3	10	1
	小計	86	68	88
投資活動		- 37	- 29	- 30
フリーキャッシュフロー		49	39	58
財務活動	社債・借入	- 2	0	0
	株式・配当金、他	- 14	- 15	- 21
	小計	- 16	- 15	- 21
増減額(含 換算差額・連結範囲変更)		+ 30	+ 25	+ 37
現金等 期末残高		303	364	408

Nov 13th, 2018

Copyright 2018 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

15

- 上期のキャッシュフロー(以下CF) について
  - 営業CFは88億円のプラス(利益計上が主因)
  - 投資CFは30億円のマイナス(設備投資等が主因)
  - この結果、上期フリーCFは58億円
  - 財務CFは21億円のマイナス
  
- この結果、上期末の現金等の残高は408億円となった



注) 上記従業員は、正社員と期末時点の臨時従業員の単純合算

Nov 13th, 2018

Copyright 2018 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

16

- 9月末の連結従業員数(正社員+期末臨時従業員)は2,972名 3月末比 151名の増加
- 増加の主因は、半導体事業での活況に伴う単体での製造人員の増加



## 次第

- ◆ 2018年度第2四半期 業績説明
- ◆ **中期目標の進捗**
- ◆ 2018年度通期業績予想
- ◆ 質疑応答

長期指標：ROE10%以上

中期目標：営業利益220億円  
(2020年度迄に)

両輪にて達成

売上拡大  
(1,100億円を目指す)

利益率向上  
(営業利益率20%以上を目指す)

- 当社は2018年5月に定量目標を開示
- 長期指標：ROE 10%以上維持
- 中期目標：20年度迄に営業利益220億円達成  
売上拡大と利益率向上の両輪で達成を目指す

**世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界No.1の商品  
を創り出し、皆様と共に大きく成長してゆく**

理念を示すモットー:

→ **「WIN-WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう」**  
*WIN-WIN relationships create the World's No. 1 Products*

コーポレートブランド:

→ **ACCRETECH**

“Accrete (共生)”と“Technology(技術)”の合成語

- 長期指標のベースにある、当社の企業理念や、枠組みに変化はない
- 企業理念は、「世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界No.1の商品を創り出し、皆様と共に大きく成長してゆく」
- これを簡潔に表すモットー、及びコーポレートブランド「ACCRETECH（アクレーテク）」を掲げ、理念の実現に取り組んでいる

## 企業理念実現のための枠組み



## 当社事業構成の特徴

## 半導体

- ・ 強み:
- ・ 精密位置決め制御技術
- ・ 内製化
- ・ チャンス:
- ・ 新技術・新デバイス

## 計測

- ・ 強み:
- ・ 高精度・高分解能測定技術
- ・ 信頼性
- ・ チャンス:
- ・ 新分野・海外需要

- ・ バランスの取れた事業構成  
- 異なる事業領域を有することによる  
安定性(需要変動影響を吸収)

## ○ 理念実現のための枠組み：

CSRやガバナンス、強固な財務基盤をベースとして  
成長投資を継続し、業績拡大と企業価値の向上を実現する

## ○ 当社事業構成の持つ強み：

半導体事業の精密位置決め制御技術や内製化、  
計測事業の高精度及び高分解能を実現する測定技術とその信頼性  
需要の波が異なるセグメントを有する事業構成が全社業績安定に寄与

## ネットワーク・通信を軸に新技術が発展、連鎖的な成長フェーズへ



Nov 13th, 2018

Copyright 2018 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

21

- 中期目標の前提となる外部環境の見方も変化はない
- 通信技術が急速に進歩し、関連技術や事業が拡大  
これらの技術がモノづくりに適用されることで、FAやIoTが更に進化
- 結果、データ、人、モノの往来が拡大するなど、連鎖的な革新が進むと予想

半導体：新たな成長ステージ ⇒短期的には変動も、長期的には堅調

- ネットワーク関連：メモリ、電子部品、センサ  
⇒短期的な需要変動はあるも、長期的には底堅い
- 車載関連：センサ、パワー、SiC基板
- 中国需要：投資本格化、新工場建設（～2019年）  
⇒懸念材料有るも、長期的には一定の進展を予想

計測：持続的な成長が継続 ⇒当初の見方に変更なし

- 自動車：プラットフォーム革新、内燃機関 開発継続
- 工作機械：需要拡大に伴うゲージ需要，IoT
- 航空機：特に新興国の中型ジェット機 需要

- 半導体は、ネットワーク関連、中国需要で短期的な変動はあるものの、長期的には底堅い成長を予想
- 計測は、持続的な成長が継続するという見方を維持  
自動車のプラットフォーム革新、内燃機関の開発継続、  
モノづくりの自動化に伴うゲージ類の引合が安定推移、  
更に中型ジェット機需要も堅調が予想され、安定成長が維持されると予想

技術面

**製品競争力強化、対象市場拡大**

生産面

**生産キャパシティの拡充  
効率改善 (自動化・省人化)**

利益率改善

**ERP導入による情報共有化促進  
サービス (フィールド、エンジニアリング) , 消耗品売上の拡充****中期目標達成**

- 目標達成のための全社戦略も変更なし
- これに伴い、中期計画内で200億超の設備投資を行う  
次ページにてその内容を説明する

**キャパシティ拡充(半導体)**

- 用地・建物取得
- 2019年度一部稼働予定
- 新工場完成までの間  
近郊の工場を貸借

**キャパシティ拡充(計測)**

- 土浦工場敷地内に  
新棟を建設
- 2020年度稼働予定

**効率化**

- ERP導入
- 2019年度稼働予定

**アプリ対応強化**

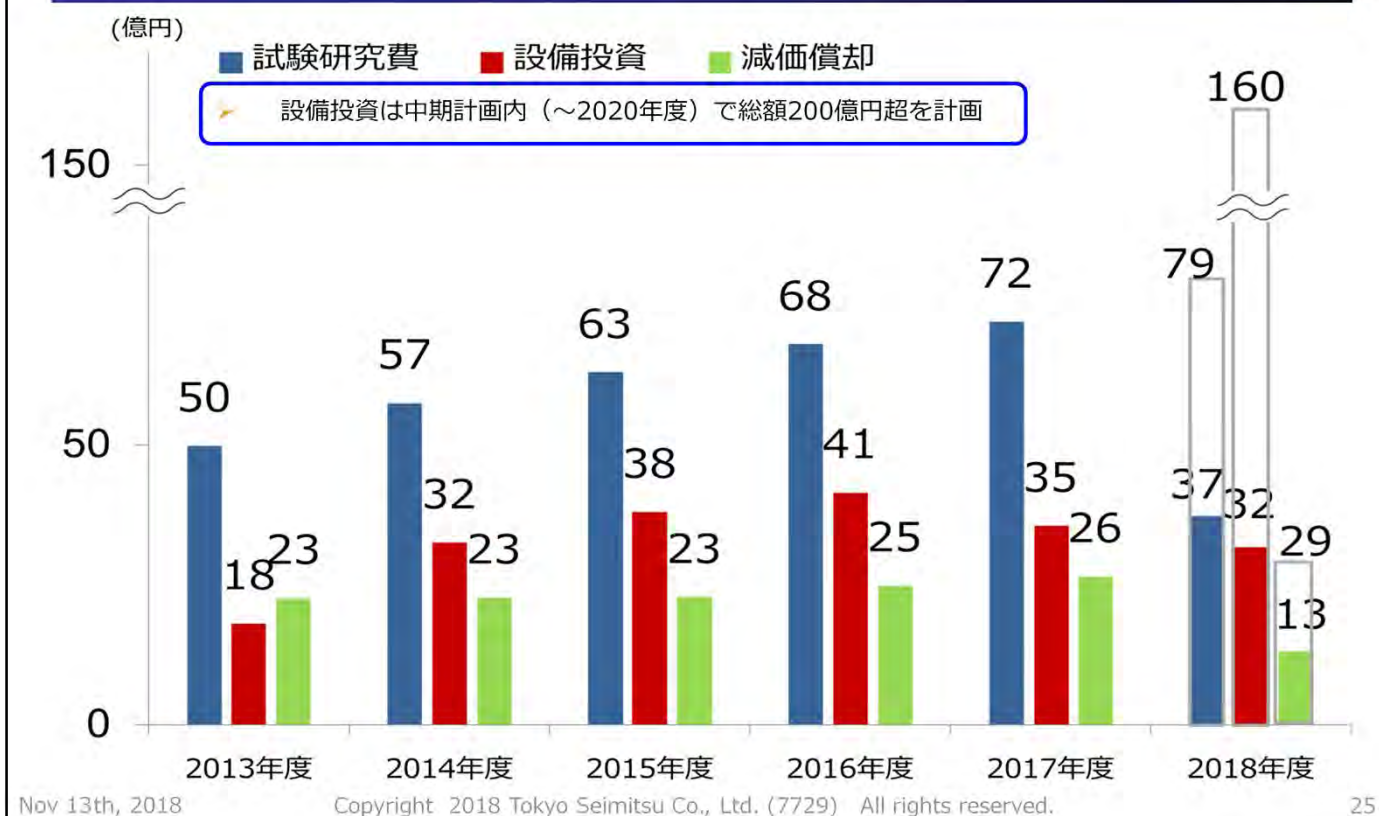
- 台湾(新竹)にて  
新アプリケーションセンター  
設立
- 2020年度稼働予定

**アプリ対応強化**

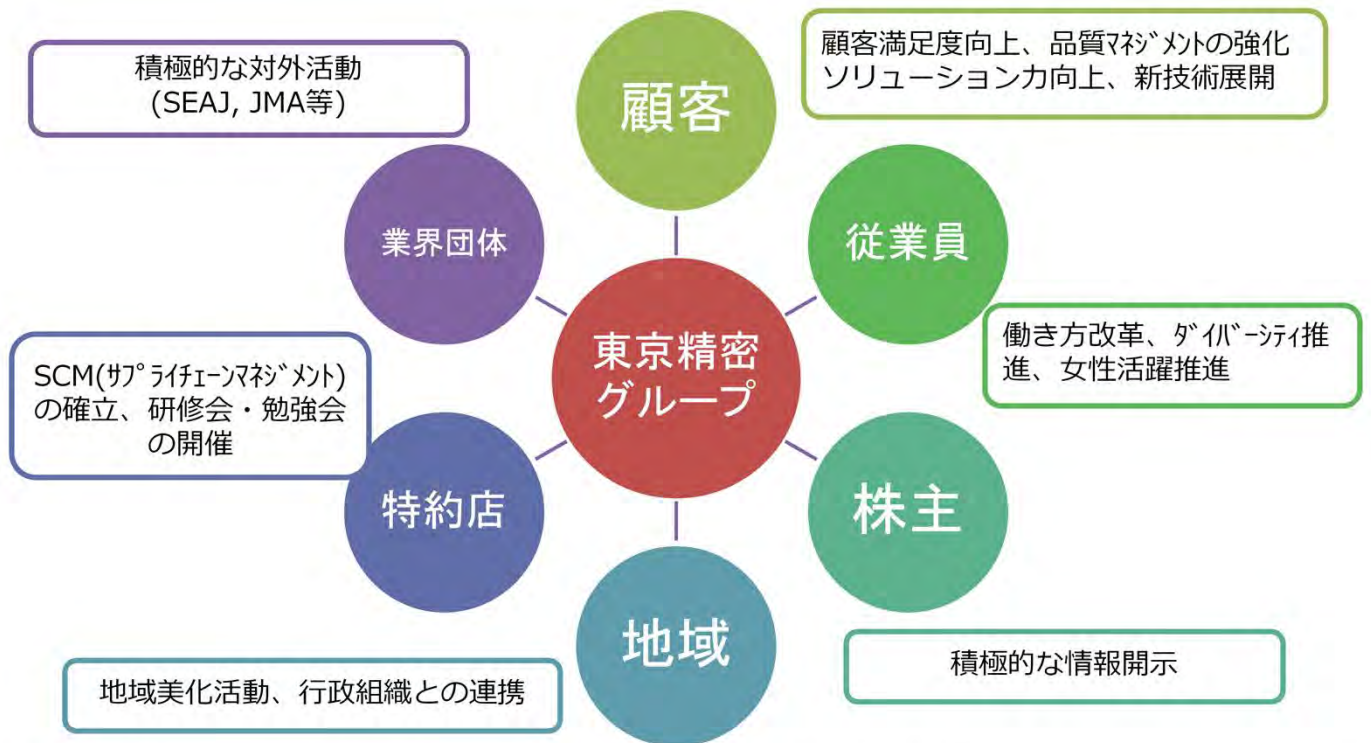
- 大阪アプリケーションセンター  
リニューアル
- 2019年度稼働予定

- 中期目標で計画している設備投資の進捗について
- 半導体事業のキャパシティ拡充：  
八王子近隣で用地建物取得、本格稼働までの間、八王子近郊の工場物件を貸借
- 計測事業のキャパシティ拡充：土浦工場の敷地内に新棟を建設
- 効率化：ERPの導入、予定通り2019年度期初より稼働
- アプリケーション強化：台湾 新アプリケーションセンター設立、大阪 アプリケーションセンターリニューアル





- 上期の試験研究費実績は37億円(製品競争力強化) 通期計画は79億円に変更なし  
(売上高の10%程度を目途としたい)
- 同 設備投資実績は32億円  
中期計画の中で総額200億円超の設備投資を計画  
設備投資計画の具体化により、通期計画は100億円→160億円へ変更
- 同 減価償却は13億円 通期計画は29億円に変更なし



- 当社は「持続可能な社会の実現」に向け、CSR活動に積極的に取り組んでいる
- 当社グループは、今後もお客様の新しい挑戦を支援する強力なパートナーであり続け、サプライヤとの協働で共に成長し続けるために、従業員の能力開発を進め、各ステークホルダーとのコミュニケーションを更に進化させていきたい

## Environment(環境)

- 環境考慮製品：LCAを考慮した環境配慮型製品の開発⇒新規開発製品への100%対応完了
- 温暖化防止：CO2排出量の削減⇒再生可能エネルギー活用による、電力使用量の削減実施

## Social (社会)

- サプライチェーン：ESGの強化改善を実施⇒全サプライヤへESG強化改善体制を拡充済
- 女性活躍推進活動：女性が活躍できる会社へ⇒女性従業員による社内活動→諸規程を改訂

## Governance(ガバナンス)

- グループ行動規範：全拠点への教育、浸透、見直し⇒行動規範のHP掲載、社員教育実施
- コンプライアンス：遵守体制の構築、教育、見直し⇒遵守体制構築、社員教育実施



今後、国連のグローバルコンパクトや関連するイニシアティブへの積極的な参加と活動を検討すべく、各種の取り組みを具体的目標をもって進める

- 当社のESGについて行う取り組みと2018年度上期の実績は記載の通り
- 現在、各種の取り組みを、具体的な目標をもって推進中  
今後は国連のグローバルコンパクトや関連するイニシアティブへの積極的な参加と活動を検討していきたい

## 次第

- ◆ 2018年度第2四半期 業績説明
- ◆ 中期目標の進捗
- ◆ **2018年度通期業績予想**
- ◆ 質疑応答

## 半導体

- 足許でメモリ投資減速の兆候があり、不透明
- 期初の想定通り、季節性（冬場まで軟調、春先に回復）を想定
- 生産は逼迫状態が続く

## 計測

- 自動車関連を中心に、国内モノづくり需要は堅調さを維持
- 米中貿易摩擦、各種通商協議の影響を注視
- 自動化対応、エンジニアリング対応への引合増加を見込む

- 18年度通期業績予想の前提となる、足許の状況
- 半導体：足許でメモリ投資減速の兆候があり、需要環境は不透明。例年通り 春先の回復に期待。一方、生産は逼迫状態が続く
- 計測：自動車関連を中心に、国内モノづくり需要は引き続き堅調一方で、米中貿易摩擦、各種通商協議の需要への影響を注視する拡大が見込まれる自動化、IoT対応への引合増を見込む

	2017年度			2018年度				
	上期	下期	通期	上期	下期 予想	通期 予想	前回 予想 対比	前年比
売上高	437	445	882	512	488	1,000	+20	+13%
半導体製造装置	303	292	595	358	332	690	+7	+16%
計測機器	133	154	287	154	156	310	+13	+8%
営業利益	89	84	173	102	84	187	+12	+8%
同率	20%	19%	20%	20%	17%	19%	-	-
経常利益	90	87	173	108	81	189	+14	+9%
当期純利益	64	64	127	79	57	136	+8	+7%
1株配当	41円	51円	92円	49円(普通配) 10円(記念配)	49円(普通配) 10円(記念配)	98円(普通配) 20円(記念配)	+4円	+26円

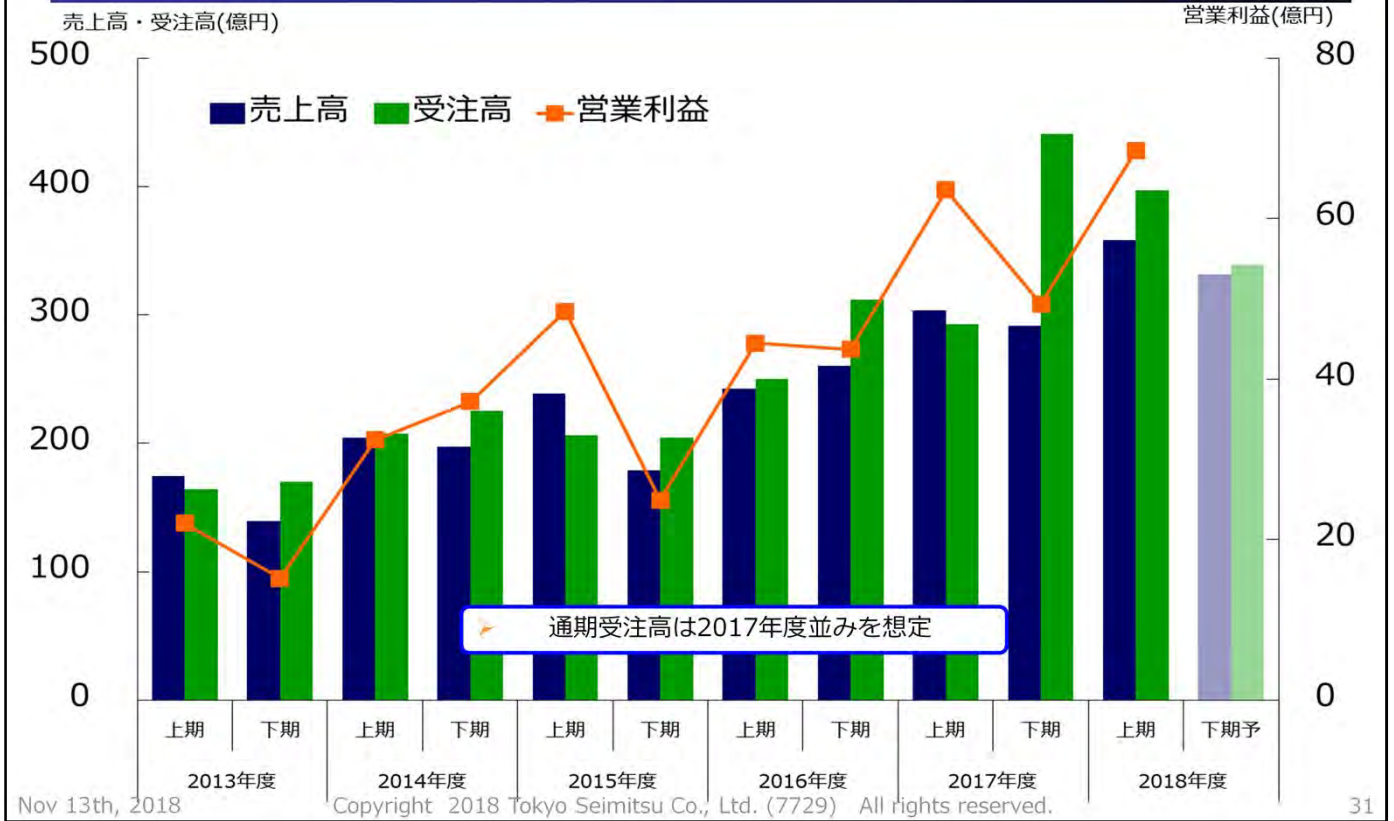
- 上期の進捗と足許の状況を反映し、2018年8月10日に公表した業績予想を修正
- あわせて、配当予想を修正

Nov 13th, 2018

Copyright 2018 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

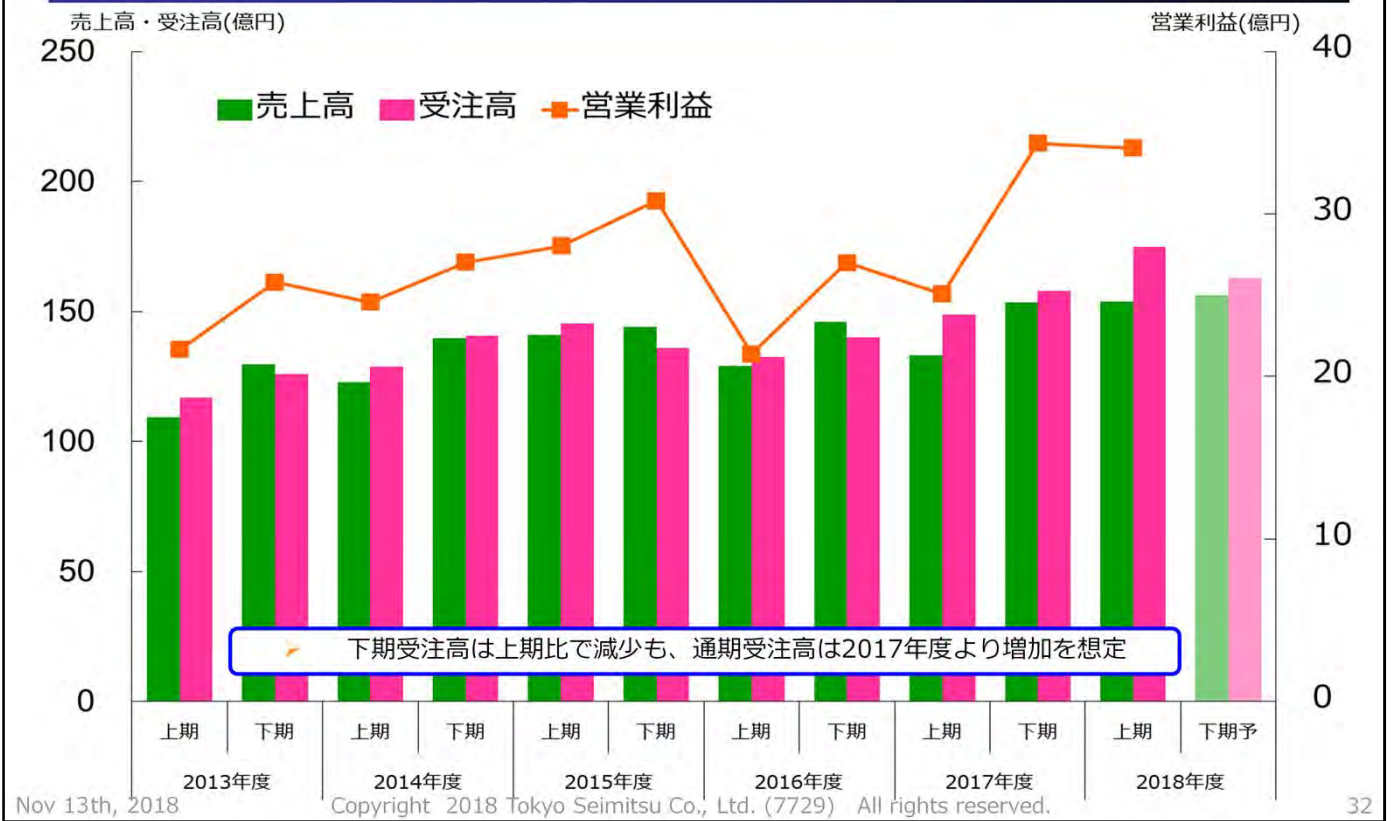
30

- 上期の進捗と足許の状況を踏まえ、18年度業績予想を修正
- 売上高 1,000億円、営業利益187億円、経常利益 189億円、当期純利益136億円を予想
- 配当方針 (配当性向30%目安)を踏まえ、通期1株配当予想を118円(普通配 98円、記念配20円)へ修正 (詳細は、2018年11月13日公表の「業績予想並びに剰余金の配当及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください)



○ 2018年度下期の受注高は上期対比減少を想定も、  
通期受注高は2017年度並みを想定

○ 2018年度下期の製品構成比の想定  
 売上高：検査装置7割、加工装置3割  
 受注高：検査装置6割半ば、加工装置3割半ば



- 2018年度下期の受注高は、上期対比で減少も、通期では2017年度を上回る水準を想定
- 2018年度下期の製品構成比の想定  
売上高、受注高共に、自動計測製品ほぼ3割、汎用計測ほぼ7割



## 次第

- ◆ 2018年度第2四半期 業績説明
- ◆ 中期目標の進捗
- ◆ 2018年度通期業績予想
- ◆ **質疑応答**



<http://www.accretech.jp/>